



**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  
SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER LA REALIZZAZIONE DI  
CIRCUITI STAMPATI (PCB)  
CIG: ZDC0838BA6**

**Data di pubblicazione: 18 gennaio 2013**

**AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE**

Il Direttore dell'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" – C.N.R. rende noto che intende procedere all'affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per la "**Realizzazione di circuiti stampati (PCB)**" CIG: ZDC0838BA6

**Oggetto d'appalto:** Realizzazione di circuiti stampati (PCB)

**Quantità, dimensioni e tipo di lavorazione:**

- 1) Quantità: 2. Dimensioni: 230x100 mm. Circuito stampato doppio strato con solder mask su entrambi i lati e serigrafia solo sul lato top;
- 2) Quantità: 2. Dimensioni: 118x100 mm. Circuito stampato doppio strato con solder mask su entrambi i lati e serigrafia solo sul lato top;
- 3) Quantità: 2. Dimensioni: 60x100 mm. Circuito stampato quattro strati con solder mask su entrambi i lati e serigrafia solo sul lato top;
- 4) Quantità: 2. Dimensioni: 165x100 mm. Circuito stampato quattro strati con solder mask su entrambi i lati e serigrafia solo sul lato top;
- 5) Quantità: 2. Dimensioni: 220x100 mm. Circuito stampato quattro strati con solder mask su entrambi i lati e serigrafia solo sul lato top;

**Specifiche tecniche minime richieste/ Specification requested:**

- Rame 35um su FR4 1,6 mm per i doppio strato mentre per i quattro strati vedere tabella sottostante

Strato Esterno di Rame	35 µm
2 X PP 7628	408 µm
Core (Layer 2 e 3) R1566 Rame 35/35 µm	0,78 mm
2 X PP 7628	408 µm
Strato Esterno di Rame	35 µm
<b>Spessore Finito Stimato</b>	<b>1,55 mm</b>

- L'isolamento tra due elementi in rame deve essere almeno 6 mils (0.15 mm);
- La dimensione minima delle piste deve essere almeno 6 mils (0.15 mm);
- Diametro foro minimo 0,20 mm per i PCB a 4 strati e 0,40 mm per i PCB a doppio strato;
- Diametro minimo della pad 0.71 mm (28 mils);
- Fori metallizzati;

- Finitura in Argento;
- OIR (Optical Inner Layer Registration): Allineamento automatizzato dei layer interni con telecamera;
- La distanza minima tra solder mask e rame deve essere di almeno 3 mils (0,20 mm);
- Test Elettrico Incluso.

**Importo massimo presunto:** € 910,00 (novecentodieci/00) IVA esclusa

**Criteri di aggiudicazione:** prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 163/06.

**Individuazione dell'Operatore economico:**

Gli operatori economici interessati a partecipare, dovranno far pervenire entro il **27 gennaio 2013**, un plico riportante la dicitura "**Avviso d'informazione CIG: ZDC0838BA6**", contenente apposita istanza di partecipazione, con allegata la fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante della Ditta. Detta istanza potrà essere anticipata a mezzo fax al numero: 055/5226488.

L'istanza dovrà essere inviata a:  
Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara"  
Via Madonna del Piano, 10  
50019 Sesto Fiorentino (FI)  
Att.ne Francesco Castagnoli (RUP)

e dovrà riportare i seguenti dati:

- Ragione sociale, indirizzo, telefono, fax ed e-mail
- Indirizzo al quale dovrà essere inviata l'eventuale documentazione di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento raccolte le istanze di cui sopra, procederà all'individuazione degli operatori economici ai quali inviare la documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il responsabile del procedimento è il Sig. Francesco Castagnoli, tel. 055/5226456, fax 055/5226488, e-mail: [f.castagnoli@ifac.cnr.it](mailto:f.castagnoli@ifac.cnr.it)

**Ulteriori informazioni:**

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.

L'IFAC-CNR si riserva di:

- non dar luogo alla successiva fase di gara con l'invio degli inviti
- non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio
- annullare la procedura

I dati raccolti saranno trattati ai fini dell'avviso e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Tale avviso è pubblicato sul sito dell'IFAC-CNR: [www.ifac.cnr.it](http://www.ifac.cnr.it) - sezione Gare e Appalti e presso il sito [www.urp.cnr.it](http://www.urp.cnr.it) - sezione gare e appalti.

Sesto Fiorentino, 18 gennaio 2013

Il Direttore  
Dr. Renzo Salimbeni




IFAC - CNR - IFAC	
Tit: IX.3	CI: ACQUISIZIO F:
<b>N. 000221</b>	<b>18/01/2013</b>

